

京东方科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-047

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	Willing Capital: Liu Zhipeng 海通国际：朱默辰
时间	2026 年 10 月 14 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	张 妍 董事会秘书室工作人员 吴易霖 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下： 1、如何看待近期面板厂的涨价行为？ 答：近期，受上游原材料价格变动及全球产业链供需变化影响，公司部分关键物料采购成本持续上行，供应链成本压力持续加大。公司结合自身成本、产品及具体交易情况制定价格政策，已就部分产品的价格事项与相关客户开展沟通，具体交易价格按照双方合同约定及协商结果确定，以保障产品品质与长期稳定供货，并确保后续技术迭代与服务能力持续提升。 2、近期 OLED 行业情况？ 答：在存储产品涨价的背景下，下游终端产品涨价逐渐传导到消费端，根据咨询机构分析和预测，2026 年下半年柔性 AMOLED 需求承压明显，行业面临量、价双降的局面。在此背景下，公司持续深化与品牌客户的技术合作与定制开发，重点布局 LTPO、折叠等高端产品，持续优化客户产品结构，积极应对行业困境。此外，公司第 8.6 代

	AMOLED 生产线自量产以来，正按计划稳步推进产能爬坡和良率提升，以对应客户高端中尺寸显示产品需求。 3、公司玻璃基先进封装业务布局及进展？ 答：公司 2020 年启动玻璃基载板技术预研，2022 年投资 3.9 亿元建设玻璃基/硅基兼容的晶圆级创新实验平台，2024 年投资 9.93 亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，并于 2025 年内完成主设备搬入调试，2026 年上半年已实现全自动化设备通线。公司目前已实现高深宽比 TGV 开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃基封装载板制造工艺能力。目前，公司试验线已实现全自动化设备通线，已有超过 100×100mm 尺寸的 24 层（11-2-11）玻璃基封装载板产出并送样，且现已通过 Pre-con、TCB 1000 cycles、UFAST、BFAST、HTSL、LTSL 信赖性标准测试。 4、公司目前钙钛矿项目进展？ 答：公司采用刚性/柔性/叠层/弱光组件技术路线并行开发，三大研发平台效率不断突破，实现了从手套箱（2.5*2.5cm）到实验线（30*30cm）再到中试线（120*240cm）三大平台全工艺流程拉齐，手套箱效率记录达 27.94%，实验线 21.39%，中试线 20.11%，柔性 16.6%。 认证方面，京东方光能已获多项国内外权威机构产品认证，标志着公司钙钛矿产品的安全性、可靠性、环保性已达到国际公认标准。2026 年 4 月，京东方光能钙钛矿户外实证基地在京东方第 10.5 代 TFT-LCD 生产线园区正式投入运行，规划总装机规模 200kW，涵盖自行生产的刚性、柔性及叠层组件，并同步引入碲化镉、晶硅（BC、TOPCon、HJT）等主流技术路线组件对比验证，构建多技术路线同台实证平台。公司计划今年第四季度在黑龙江漠河（极寒）、新疆吐鲁番（干热沙尘 50 度以上）和宁夏银川（高辐射、大温差）开展极致条件实证测试。 5、公司目前光互连项目进展？ 答：公司已成立 Micro LED 光互连系统及玻璃载板 CPO 技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无
日期	2026 年 10 月 14 日

